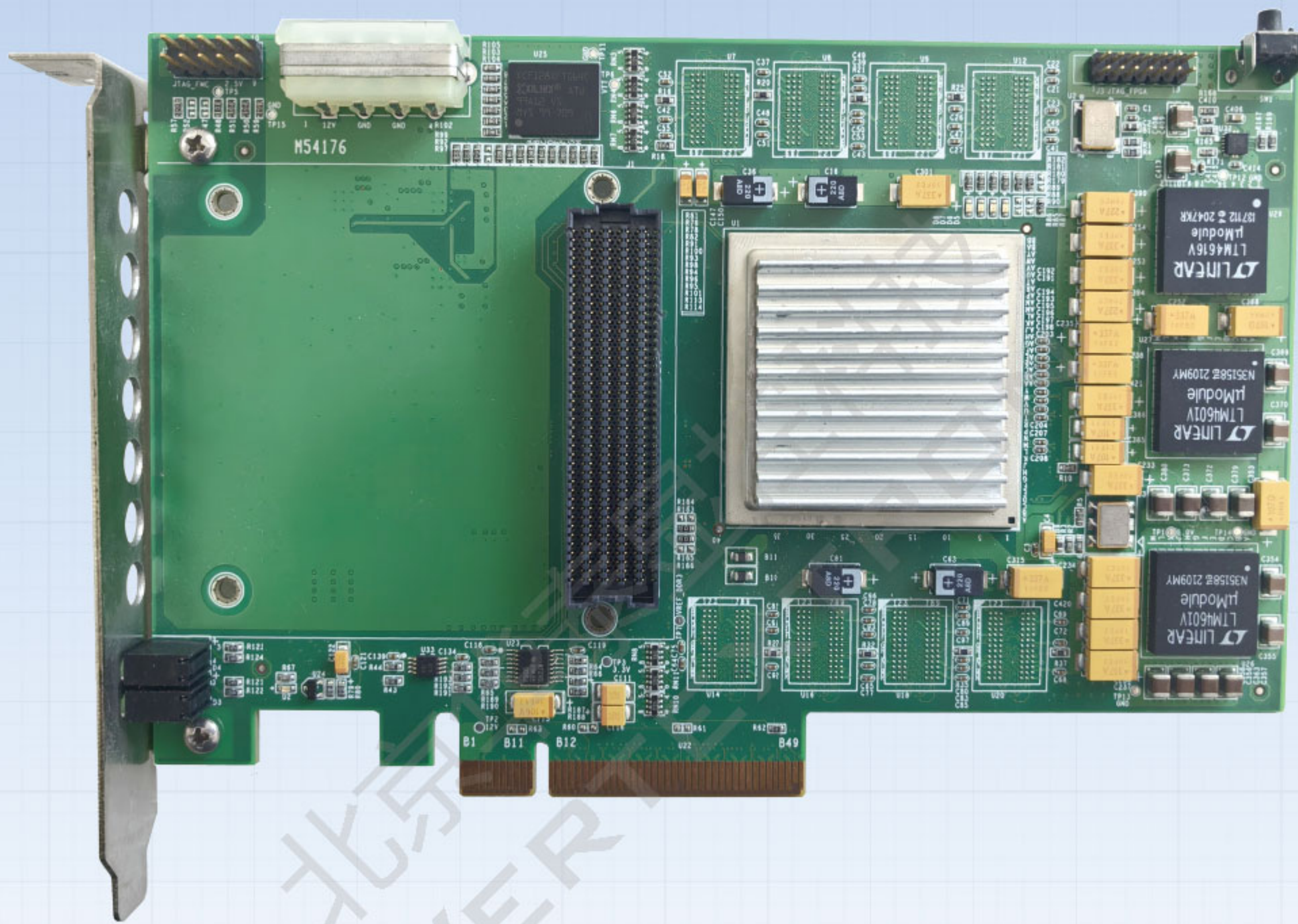


PCIe-801FMC

PCI Express 总线(PCIe)通用FMC载板



基本特征/FEATURES

- 符合PCI Express总线规范；全高、半长卡
- FPGA：XC7VX690T
- FPGA挂载两组DDR3 SDRAM，每组63bit、4GB
- 启动配置：板载1片256Mb的NOR FLASH，FPGA采用QSPI串行启动配置方式
- PCIe接口：PCIe3.0, X8
- 支持JTAG在线调试；前面板LED状态指示灯；支持被动散热
- 支持 Win7/10/11-64位,Linux/Ubuntu,VxWorks等系统
- 工作温度：-40°~+70°C



基本参数/SPECIFICATIONS

产品概述	PCIe-801FMC板卡采用Xilinx公司的XC7VX690T芯片作为主处理器。挂载两组DDR3 SDRAM缓存器，提供1个FMC模块扩展接口，扩展不同的FMC模块可实现高速数据采集，播放、数据存储等功能。	
技术指标	PC接口	支持PCIe3.0, X8
	主处理器 (FPGA)	XC7VX690T
	板载缓存器	两组DDR3 SDRAM缓存器，每组配置容量4GB，位宽63bit
	启动配置	板载1片256Mb的NOR FLASH；FPGA采用QSPI串行启动配置方式
	在线调试	支持JTAG在线调试
	面板LED	支持前面板LED状态指示功能，包括板卡电源状态、运行状态指示等
	板卡散热	支持被动风冷和主动散热选配
	软件支持	可选集成板级软件开发包（BSP）
电气及物理特性	系统支持	支持 Win7/10/11-64位,Linux/Ubuntu,VxWorks等系统；提供Linux驱动及测试软件
	板卡尺寸	标准 PCI Express 全高、半长卡、单槽宽
	板卡供电	PCIe接口供电，DC12V±%5
	散热方式	加装散热片被动散热，支持选配主动散热（带风扇）
	环境温度	工作温度：-40°C ~ +70°C；存储温度：-40°C ~ +85°C
产品订购信息	工作湿度	5%~95%，非凝结
	名称型号	PCIe总线通用FMC载板：PCIe-801FMC
		配套BSP包（请与我司人员联系）
		相关配套系统驱动程序
应用场合	图像采集系统	
	高速模拟数据采集光纤传输系统	
	雷达系统半实物仿真	
	网络硬件加速平台	

板卡功能框图

